

第 47 回インターネットコンジャンパン 2018 の展示会のご案内

会期:2018 年 1 月 17 日(水)~19 日(金)

【ブース番号:東 1 ホール E4-4 東京ビッグサイト】

拝啓 貴社ますますご盛栄のこととお喜び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。

さて、この度は弊社では「第 47 回インターネットコンジャンパン 2018」に出展する運びとなりましたので、ご案内申し上げます。展示予定装置は下記の通りです。

インターネットコンジャンパン展示予定装置・テクノロジー

1. 高精密・高精度を要求される複雑な PCB・FPC を非接触、メカニカルストレスを与えずクリーンなカットが可能なレーザー基板分割機「LPKF MicroLine 2000 シリーズ」
2. 日本国内で 2000 台以上の販売実績。迅速な試作基板加工を卓上型サイズの装置で実現「LPKF ProtoMat S63」
3. 半導体チップの接続に使用されるガラスインターポーザー向けの精密なスルーホール加工を実現できるガラスインターポーザー用超高速レーザー加工装置
「LPKF Vitron® 5000」(当日は、サンプルのみお見せ致します。)
4. 既存のレーザー溶着では実現の難しかった、透明樹脂同士(例:アクリル、COP、PP 等)の溶着を接着剤無、樹脂添加剤無で実現するレーザー溶着テクノロジー
(サンプル展示)
5. 従来の PCB ではできなかった 3 次元筐体回路(=MID)をレーザーで直接筐体に回路を作成することで小型化かつ基板レスを実現「LPKF-LDS®工法」

アポイントをご希望の方は下記に必要事項をご記入の上、FAX またはメールにてご返信いただきますようお願い申し上げます。

敬具

LPKF Laser & Electronics 株式会社

【マーケティング担当:高橋寛規】

【047-432-5100】

【<http://jp.lpkf.com>】

=====アポイントメントシート=====

【返信先 FAX: 047-432-5104】 【返信先 E-mail: hiroki.takahashi@lpkf.com】

必要事項をご記入の上、FAX またはメールにてご返信ください。

御社名:

お名前:

部署・役職:

E-mail:

ご来場予定日時:2018 年 1 月 17 日(水)・18 日(木)・19 日(金) ____ 時頃希望

※17・18 日は 10 時~18 時まで、19 日は 10 時~17 時まで開催しております。

ご興味のある製品などまた現状抱えている課題などございましたら下記にてご記入ください。

[]